



# LEITPROJEKT 2016

## ► Energieeffiziente Elektronik-Produktion – Wellenlöten mit niedrigschmelzendem Lot



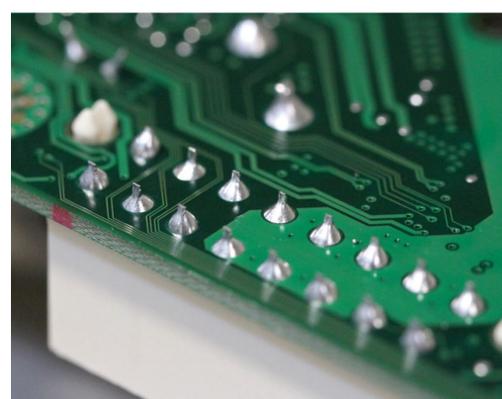
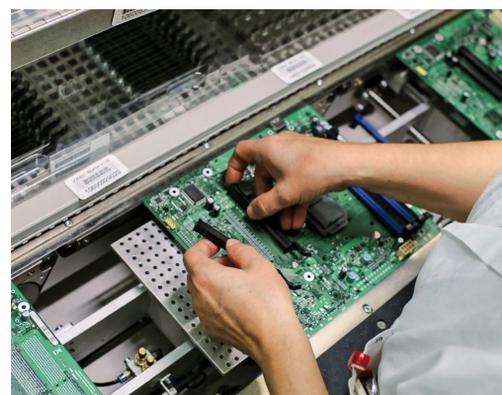
Standard-Lotlegierungen auf Basis von Zinn und Kupfer haben einen Schmelzpunkt von ca. 230 °C. Bei Fujitsu in Augsburg wurde für das Wellenlöten in der Elektronik-Produktion eine niedrigschmelzende Legierung auf Basis von Bismut, Zinn und Silber mit einem Schmelzpunkt von nur 138 °C erstmalig qualifiziert.

### Die wesentlichen Vorteile sind:

- 40 % weniger Energieverbrauch beim Wellenlötprozess,
- deutliche Verbesserung der Lötqualität und
- ca. 50 % weniger Abfälle.

In der Serienfertigung konnten auf vier Produktionslinien mit dem neuen Verfahren bereits mehr als 1,3 Millionen Mainboards erfolgreich gefertigt werden. Die Anwendung des Wellenlötens mit niedrigschmelzendem Lot auf weitere Produktionslinien ist geplant.

Das Energieeinsparpotenzial pro Jahr beläuft sich auf etwa 250.000 kWh. Das entspricht einer Reduzierung der Treibhausgase um rund 140t bei deutschem Strommix.



## ► Projektträger



**Fujitsu Technology Solutions GmbH**  
Bürgermeister-Ulrich-Straße 100  
86199 Augsburg  
[www.fujitsu.com/de/about/local/augsburg/](http://www.fujitsu.com/de/about/local/augsburg/)

**Ansprechpartner**  
Michael Erhard  
Fujitsu Central Europe  
Telefon 089 307686-237  
[michael.erhard@ts.fujitsu.com](mailto:michael.erhard@ts.fujitsu.com)

FÜR WACHSENDE  
UMWELTKOMPETENZ

[www.kumas.de](http://www.kumas.de)